

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務—我們的增長戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除與[編纂]有關的[編纂]及其他估計開支後，我們估計將從[編纂]中獲得約[編纂]百萬港元的[編纂]淨額(假設[編纂]未獲行使)。我們擬按下列用途及金額使用[編纂]。

- 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於投資關鍵技術及核心業務的研發。具體而言：
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將於未來五至十年用於招募、培訓及挽留研發人才(包括校園招聘及資深專業人士)，以進一步擴展及升級我們的IP組合，並使我們的IP適應AI時代的應用場景。尤其是，我們擬迭代優化及提升(其中包括)我們的GPGPU IP、AI-ISP IP、AI-DSP IP、AI-Video IP、AI-Display IP、高速接口IP、用於基於Chiplet架構的Die-to-Die接口IP、無線通信射頻IP、車規級IP以及用於端側AI應用的超低能耗IP系列；
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將於未來五至十年用於招募、培訓及挽留研發人才(包括校園招聘及資深專業人士)，以便：(1)透過開發及迭代用於邊緣側AI設備(如AI智能手機、AI PC、AI Pad、AI眼鏡、AI玩具、AI戒指)、智慧汽車、機器人及其他實體AI應用，以及數字療法、腦機接口及其他醫療保健應用的芯片定制平台，將我們的芯片定制平台從雲側AI部署擴展至邊緣AI部署；及(2)透過開發及迭代基於Chiplet的平台架構，並建立先進封裝工程能力，將我們的芯片定制平台從SoC擴展至SiP，以滿足不斷發展的異構計算及智能駕駛需求；
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於採購研發及工程材料與設備。具體而言，我們擬繼續購買EDA工具、第三方IP及其他研發相關軟件；仿真、模擬及測試設備；用於研發流片的工程晶圓等；
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於投資研發中心，包括收購辦公場所；
- 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於進一步發展我們的全球營銷網絡，擴展及升級我們的區域銷售及客戶支持能力，深化與關鍵領域生態系統合作夥伴的合作，從而進一步鞏固我們在半導體行業價值鏈中的地位及我們的長期可持續發展能力；

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於與我們核心業務具有協同效應並能提升我們的IP組合、服務產品及市場准入的戰略投資及／或收購。我們可能會選擇性地進行少數股權投資、多數股權收購或全面整合。[編纂]用途可能涵蓋目標評估、交易執行及投資後整合。

截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體目標，亦未訂立任何最終協議；資金部署將取決於估值、盡職調查及監管批准。

- 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途，包括日常營運及一般企業開支，以在業務增長期間提供財務靈活性。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]淨額將為[編纂]百萬港元。倘[編纂]定於較本文件所述[編纂]範圍中位數為高或低的水平，[編纂][編纂]淨額將按比例分配至上述用途。

倘我們發展計劃的若干部分因政府政策變動或不可抗力事件等因素而受阻，我們的董事將仔細評估情況，並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。倘[編纂]的預定用途有任何重大變動，我們將根據香港上市規則作出適當披露。

倘[編纂][編纂]項淨額未立即用於上述用途，或倘我們無法按預期實施未來發展計劃的任何部分，我們僅會將該等資金存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(定義見《證券及期貨條例》或其他司法權區的適用法律及法規)的短期計息賬目。在該情況下，我們將遵守香港上市規則項下的適當披露規定。